

2022-2028年中国电子设计 自动化(EDA)软件市场发展趋势与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2022-2028年中国电子设计自动化(EDA)软件市场发展趋势与投资前景分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/U72719D7MG.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

电子设计自动化（英语：Electronic design automation，缩写：EDA）是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。

智研数据研究中心发布的《2022-2028年中国电子设计自动化(EDA)软件市场发展趋势与投资前景分析报告》共十二章。首先介绍了电子设计自动化(EDA)软件行业市场发展环境、电子设计自动化(EDA)软件整体运行态势等，接着分析了电子设计自动化(EDA)软件行业市场运行的现状，然后介绍了电子设计自动化(EDA)软件市场竞争格局。随后，报告对电子设计自动化(EDA)软件做了重点企业经营状况分析，最后分析了电子设计自动化(EDA)软件行业发展趋势与投资预测。您若想对电子设计自动化(EDA)软件产业有个系统的了解或者想投资电子设计自动化(EDA)软件行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 电子设计自动化（EDA）软件相关概述

1.1 芯片设计基本概述

1.1.1 芯片生产流程图

1.1.2 芯片设计的地位

1.1.3 芯片设计流程图

1.2 EDA软件基本介绍

1.2.1 EDA软件基本概念

1.2.2 EDA软件主要功能

1.2.3 EDA软件的重要性

1.3 EDA软件主要类型

1.3.1 EDA常用软件

1.3.2 电路设计与仿真工具

1.3.3 PCB设计软件

- 1.3.4 IC设计软件
- 1.3.5 其它EDA软件
- 1.4 EDA软件的设计过程及步骤
 - 1.4.1 EDA软件设计过程
 - 1.4.2 EDA软件设计步骤

第二章 EDA软件行业发展环境分析

2.1 经济环境

- 2.1.1 宏观经济概况
- 2.1.2 对外经济分析
- 2.1.3 工业运行情况
- 2.1.4 固定资产投资
- 2.1.5 转型升级态势
- 2.1.6 疫后经济展望

2.2 政策环境

- 2.2.1 芯片产业政策汇总
- 2.2.2 产业投资基金支持
- 2.2.3 税收优惠政策扶持
- 2.2.4 地区发布补助政策
- 2.2.5 技术限制政策动态
- 2.2.6 科技产业发展战略

2.3 技术环境

- 2.3.1 国家研发支出增长
- 2.3.2 知识产权保护增强
- 2.3.3 芯片技术创新升级
- 2.3.4 芯片设计专利统计
- 2.3.5 海外发明授权规模

第三章 产业环境——芯片设计行业全面分析

3.1 2016-2020年全球芯片设计行业发展综述

- 3.1.1 市场发展规模
- 3.1.2 区域市场格局

- 3.1.3 市场竞争格局
- 3.1.4 企业排名分析
- 3.2 2016-2020年中国芯片设计行业运行状况
 - 3.2.1 行业发展历程
 - 3.2.2 市场发展规模
 - 3.2.3 专利申请情况
 - 3.2.4 资本市场表现
 - 3.2.5 细分市场发展
- 3.3 中国芯片设计市场发展格局分析
 - 3.3.1 企业排名状况
 - 3.3.2 企业竞争格局
 - 3.3.3 区域分布格局
 - 3.3.4 产品类型分布
- 3.4 芯片设计具体流程剖析
 - 3.4.1 规格制定
 - 3.4.2 设计细节
 - 3.4.3 逻辑设计
 - 3.4.4 电路布局
 - 3.4.5 光罩制作
- 3.5 芯片设计行业发展存在的问题和对策
 - 3.5.1 行业发展瓶颈
 - 3.5.2 行业发展困境
 - 3.5.3 产业发展建议
 - 3.5.4 产业创新策略

第四章 2016-2020年全球EDA软件行业发展分析

- 4.1 全球EDA市场发展综况
 - 4.1.1 行业发展特征
 - 4.1.2 行业发展规模
 - 4.1.3 从业人员规模
 - 4.1.4 细分市场格局
 - 4.1.5 区域市场格局

- 4.1.6 企业竞争格局
- 4.1.7 企业发展要点
- 4.2 美国EDA市场发展布局
 - 4.2.1 产业背景分析
 - 4.2.2 政策支持项目
 - 4.2.3 企业补助情况
 - 4.2.4 企业发展布局
- 4.3 全球EDA软件行业发展趋势
 - 4.3.1 AI融合或成重点
 - 4.3.2 汽车应用需求强烈
 - 4.3.3 工具和服务的云化趋势

第五章 2016-2020年中国EDA软件行业发展分析

- 5.1 EDA软件行业发展价值分析
 - 5.1.1 后摩尔时代的发展动力
 - 5.1.2 EDA是数字经济的支点
 - 5.1.3 EDA降低芯片设计成本
 - 5.1.4 加快与新型科技的融合
 - 5.1.5 推进芯片国产化的进程
- 5.2 中国EDA软件产业链分析
 - 5.2.1 产业链结构
 - 5.2.2 相关上市企业
 - 5.2.3 下游应用主体
- 5.3 中国EDA软件行业发展综况
 - 5.3.1 行业发展阶段
 - 5.3.2 企业研发历程
 - 5.3.3 市场发展规模
 - 5.3.4 市场份额占比
 - 5.3.5 市场竞争格局
- 5.4 中国EDA软件行业发展问题及对策
 - 5.4.1 产品发展问题
 - 5.4.2 人才投入问题

- 5.4.3 市场培育问题
- 5.4.4 工艺缺乏问题
- 5.4.5 行业发展对策

第六章 2016-2020年EDA软件国产化发展分析

- 6.1 中国芯片国产化进程分析
 - 6.1.1 芯片国产化发展背景
 - 6.1.2 核心芯片的自给率低
 - 6.1.3 芯片国产化进展分析
 - 6.1.4 芯片国产化存在问题
 - 6.1.5 芯片国产化未来展望
- 6.2 国产化背景——美国对中国采取科技封锁
 - 6.2.1 美国芯片封锁法规
 - 6.2.2 商业管制范围拓展
 - 6.2.3 商业管制影响领域
 - 6.2.4 EDA纳入管制清单
- 6.3 EDA软件国产化发展综况
 - 6.3.1 国内EDA软件国产化历程
 - 6.3.2 国内EDA软件国产化加快
 - 6.3.3 国产EDA软件的发展机遇
 - 6.3.4 国产EDA软件的发展要求
- 6.4 EDA软件国产化的瓶颈及对策
 - 6.4.1 国产化瓶颈分析
 - 6.4.2 国产化对策分析

第七章 2016-2020年EDA软件相关产业分析——芯片IP

- 7.1 芯片IP的基本概述
 - 7.1.1 芯片IP基本内涵
 - 1.1.1 芯片IP发展地位
 - 7.1.2 芯片IP主要类别
 - 7.1.3 芯片IP的特征优势
- 7.2 芯片IP市场发展综况

- 7.2.1 全球市场规模
- 7.2.2 行业发展特点
- 7.2.3 全球竞争格局
- 7.2.4 国内市场状况
- 7.2.5 国内市场建议
- 7.2.6 市场发展热点
- 7.3 芯片IP技术未来发展趋势
 - 7.3.1 技术工业融合趋势
 - 7.3.2 研发遵循相关原则
 - 7.3.3 新型产品研发趋势
 - 7.3.4 AI算法技术推动趋势
 - 7.3.5 研发应用平台化态势
 - 7.3.6 开源IP设计应用趋势

第八章 EDA软件技术发展分析

- 8.1 EDA软件技术发展历程
 - 8.1.1 计算机辅助阶段（CAD）
 - 8.1.2 计算机辅助工程阶段（CAE）
 - 8.1.3 电子设计自动化阶段（EDA）
- 8.2 EDA软件技术标准分析
 - 8.2.1 EDA设计平台标准
 - 8.2.2 硬件描述语言及接口标准
 - 8.2.3 EDA系统框架结构
 - 8.2.4 IP核标准化
- 8.3 EDA软件技术的主要内容
 - 8.3.1 大规模可编程逻辑器件（PLD）
 - 8.3.2 硬件描述语言（HDL）
 - 8.3.3 软件开发工具
 - 8.3.4 实验开发系统
 - 8.3.5 EDA技术的应用
- 8.4 EDA技术主要应用领域
 - 8.4.1 科研应用方面

- 8.4.2 教学应用方面
- 8.5 EDA技术应用于电子线路设计
 - 8.5.1 技术实现方式
 - 8.5.2 技术实际应用
 - 8.5.3 技术应用要求
- 8.6 智能技术与EDA技术融合发展
 - 8.6.1 技术融合发展背景
 - 1.1.1 技术融合发展优势
 - 8.6.2 技术研发布局加快
 - 8.6.3 融合技术应用分析
 - 1.1.1 技术融合发展问题
 - 8.6.4 技术融合发展展望
 - 8.6.5 技术融合发展方向
- 8.7 EDA软件技术发展壁垒
 - 8.7.1 需要各环节协同合作
 - 8.7.2 需要大量的理论支撑
 - 8.7.3 需要大量综合性人才

第九章 全球主要EDA软件企业发展分析

- 9.1 Synopsys
 - 9.1.1 企业基本概况
 - 9.1.2 企业布局动态
 - 9.1.3 商业模式创新
 - 9.1.4 财务运营状况
 - 9.1.5 研发投入状况
 - 9.1.6 企业收购情况
- 9.2 Cadence
 - 9.2.1 企业基本概况
 - 9.2.2 产品范围分析
 - 9.2.3 商业模式创新
 - 9.2.4 财务运营状况
 - 9.2.5 研发投入状况

- 9.2.6 企业收购情况
- 9.3 Mentor Graphics
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 主要产品概述
 - 9.3.3 财务运营状况
 - 9.3.4 企业收购情况
- 9.4 三大企业的发展比较分析
 - 9.4.1 发展优势比较
 - 9.4.2 产品服务对比
 - 9.4.3 主要客户对比
 - 9.4.4 中国市场布局

第十章 中国EDA软件企业发展分析

- 10.1 华大九天
 - 10.1.1 企业发展概况
 - 10.1.2 业务布局领域
 - 10.1.3 客户覆盖范围
 - 10.1.4 企业发展成果
- 10.2 芯禾科技
 - 10.2.1 企业发展概况
 - 10.2.2 主要产品分析
 - 10.2.3 企业融资布局
 - 10.2.4 企业发展动态
- 10.3 广立微电子
 - 10.3.1 企业发展概况
 - 10.3.2 产品服务领域
 - 10.3.3 重点产品概述
 - 10.3.4 市场覆盖范围
- 10.4 概伦电子
 - 10.4.1 企业发展概况
 - 10.4.2 主要产品分析
 - 10.4.3 企业融资动态

- 10.4.4 市场覆盖范围
- 10.5 芯愿景
 - 10.5.1 企业发展概况
 - 10.5.2 主营业务分析
 - 10.5.3 主要经营模式
 - 10.5.4 财务运营状况
- 10.6 其他相关企业
 - 10.6.1 博达微科技
 - 10.6.2 天津蓝海微科技
 - 10.6.3 成都奥卡思微电科技
 - 10.6.4 智原科技股份有限公司

第十一章 2016-2020年中国EDA软件行业投资分析

- 11.1 EDA软件行业投资机遇
 - 11.1.1 技术创新发展机遇
 - 11.1.2 人才供给改善机遇
 - 11.1.3 资本环境改善机遇
- 11.2 EDA软件行业融资加快
 - 11.2.1 大基金融资动态
 - 11.2.2 科创板融资动态
- 11.3 EDA软件项目投资动态
 - 11.3.1 中科院青岛EDA中心项目
 - 11.3.2 国微深圳EDA开发项目
 - 11.3.3 集成电路设计创新中心项目
 - 11.3.4 芯禾电子完成C轮项目融资
 - 11.3.5 概伦电子获得A轮项目融资
 - 11.3.6 立芯华章EDA创新中心项目
 - 11.3.7 合肥市集成电路服务平台项目
- 11.4 EDA软件行业投资风险
 - 11.4.1 技术风险分析
 - 11.4.2 人员流失风险
 - 11.4.3 贸易摩擦风险

- 11.4.4 市场竞争风险
- 11.4.5 法律风险分析
- 11.5 EDA软件行业投资要点
 - 11.5.1 紧紧围绕发展驱动因素
 - 11.5.2 强抓产业发展的核心
 - 11.5.3 建立具备复合经验团队
 - 11.5.4 加深产业投资规律理解

第十二章 2022-2028年EDA软件行业发展前景预测分析

- 12.1 中国芯片设计行业发展前景
 - 12.1.1 技术创新发展（ ）
 - 12.1.2 市场需求状况
 - 12.1.3 行业发展前景
- 12.2 中国EDA软件行业发展前景
 - 12.2.1 整体发展机遇
 - 12.2.2 整体发展前景
 - 12.2.3 国内发展机会
 - 12.2.4 国产化发展要点
- 12.3 2022-2028年中国EDA软件行业预测分析
 - 12.3.1 中国EDA软件行业的影响因素分析
 - 12.3.2 2022-2028年EDA软件行业规模预测

图表目录

- 图表 芯片生产历程
- 图表 IC产业链
- 图表 芯片设计和生产流程图
- 图表 EDA软件处于半导体产业链的上游环节
- 图表 中国芯片产业相关政策汇总（一）
- 图表 中国芯片产业相关政策汇总（二）
- 图表 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标
- 图表 一期大基金投资各领域份额占比
- 图表 一期大基金投资领域及部分企业

图表 EDA产业限制政策梳理

图表 芯片设计流程图

图表 芯片设计流程

图表 32bits加法器的Verilog范例

图表 光罩制作示意图

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/U72719D7MG.html>